



KCS 2027 전시업체 기업소개서

	대 표 자	전석환
	홈페이지	https://www.mkpsemi.com/main
	이 메 일	mkpsales@mkpsemi.com
	전화번호	031-613-3359
	주 소	경기도 화성시 동탄구 삼성1로 1길 40 (석우동 24-6)
	주요물품	MFC, MFM, FRC, EPC, LMFC

회사소개

□ 회사 소개

엠케이피(주)는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 사용되는 핵심 부품을 특허받은 순수 국산 기술로 개발·양산한 국내 최초, 유일한 기업입니다. 엠케이피 고유의 기술력으로 MFC(PS MFC, PI MFC, 고온용 MFC, Liquid MFC), FRC, EPC 등 외산 기업이 독점으로 공급하고 있는 부품들을 국산화에 성공하였으며, 이를 통해 반도체, 디스플레이, 에너지, 조선, 의료산업 전반에 질량유량 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 엠케이피는 대한민국을 대표하는 Mass Flow Total Solution 전문 기업으로, 지속적인 기술 혁신과 품질 경쟁력 향상을 통해 한국 반도체 산업 발전에 기여하고 있으며, 글로벌 시장 진출에도 박차를 가하고 있습니다.

□ 사업 연혁

2025년 12월 : 우수 기업부설연구소 지정 (과학기술정보통신부)
 2025년 09월 : 평택 제조 캠퍼스 준공
 2025년 08월 : 한국진공학회 진공기술상 수상
 2024년 09월 : 인적자원개발 우수기관 (Best-HRD) 선정
 2024년 03월 : DB하이텍 협력업체 정식 등록
 2023년 12월 : 제1회 화성시 중소기업 대상 수상
 2023년 04월 : 글로벌 강소기업 1000+ 선정
 2023년 03월 : 중국 상해법인 설립
 2023년 02월 : SEMI INNOVATION AWARD 수상
 2022년 06월 : 삼성디스플레이 MFC 적용
 2021년 10월 : 제조 제2캠퍼스 확장
 2021년 07월 : 스마트공장 고도화 구축 완료



2020년 11월 : 액체/전구체용 MFC 개발 완료 (ARI7000s)
 2020년 11월 : 고온용 MFC 개발 완료 (MARU8000s)
 2020년 11월 : 산업통상자원부 소부장 핵심전략 기술 선정
 2020년 10월 : 중소벤처기업부 소부장 히든 챔피언 선정
 2020년 08월 : 전자식압력제어기(EPC) 개발 완료 (BARON3000s)
 2019년 11월 : 유량비율분배기(FRC) 개발 완료 (MADEE5000s)
 2019년 08월 : LG디스플레이 MFC 적용
 2019년 07월 : SK하이닉스 협력업체 정식 등록
 2019년 06월 : 삼성전자 PS MFC Common Spec. 등재
 2018년 04월 : 삼성전자 DS사업부 정식 협력업체 등록
 2018년 02월 : 차압식 MFC 개발 완료 (MARU9000s)
 2016년 03월 : 기업부설연구소 설립
 2016년 03월 : 엠케이피(주) 법인 설립

□ 주요 고객사

- 삼성반도체, SK하이닉스,
- 원익IPS, TES, ASM, PSK, SEMES, 주성엔지니어링, 유진테크, AP System, VM, KC-Tech
- 삼성디스플레이, LG디스플레이, ICD, H&이루자

□ 주요 제품

제품명 : MFC (Mass Flow Controller)

제품설명 : ◦ 반도체 장비의 챔버에 공급되는 가스의 유량을 정밀하게 계측하고 제어함. ◦ PS MFC, PI MFC, 대유량 MFC(500SLM), 고온용 MFC, Liquid MFC 라인업 보유 ◦ 외부리크, 재현성, 내부식성, 압력헌팅에 대한 안정성 등 우수



제품명 : FRC (Flow Ratio Controller)

제품설명 : ◦ 반도체 장비에서 가스의 유량을 사용자가 원하는 비율대로 프로세스 챔버에 균일하게 공급함. ◦ 분리형 FRC, 일체형 FRC 라인업 보유. ◦ 분리형 FRC: 2~6 채널 지원 / 일체형 FRC: 2~4 채널 지원



제품명 : EPC (Electronic Pressure Controller)

제품설명 : ◦ 반도체나 디스플레이 Dry Etcher 장비에서 가스의 압력을 균일하게 공급함. ◦ Dry Etcher 장비에서 웨이퍼 수율 향상을 위해 웨이퍼 후면을 Cooling 하기 위한 용도로 주로 사용됨.



□ 경영 현황

